

## PERSBERICHT

### Neways pioniert in miniaturisering

#### *Presenteert doorbraak op CICMT 2017 in Japan*

**Son, 12 april 2017** – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel de “Onderneming”) maakt vandaag bekend dat een belangrijke stap is gezet in de ontwikkeling van high density keramische substraten. Voor Neways is het nu mogelijk om met bestaande conventionele zeefdruktechniek keramische substraten te voorzien van structuren van minder dan 50 µm line/gap spacing, een doorbraak in de miniaturisering van geïntegreerde elektronica.

De ontwikkeling, geïnitieerd door Neways Micro Electronics, onderdeel van de Neways Groep, maakt elektronische verbindingen tussen *fine pitch integrated circuits* (ofwel *advanced IC packages*) op minimale oppervlakten mogelijk. Met lithografische technieken kan dit daarnaast op kostenefficiënte wijze.

Deze ontwikkeling sluit aan op de continue miniaturisatie van geïntegreerde elektronica. Componenten worden steeds kleiner terwijl zij tegelijkertijd meer functionaliteit krijgen en dichter bij de bron geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld op een motor of in een ventiel. Deze innovatie heeft tal van toepassingen in verscheidene sectoren. Hierbij kan gedacht worden aan nagenoeg onzichtbare gehoorapparaatjes, opto-elektronische datatransmitters, medische implantaten of sensoren van auto's.

Daniel Mitcan, Manager Engineering bij Neways Micro Electronics:

“Het is een algemene regel dat het aantal transistoren op een chip elke twee jaar verdubbelt (De Wet van Moore). De keramische drager werd echter lange tijd niet navenant kleiner. Het bijzondere aan dit project is dat we conventionele methodes - die al twintig jaar gangbaar zijn – los hebben gelaten, waardoor we met een frisse blik naar geavanceerde lithografische technologieën konden kijken. Een combinatie van deze technieken zorgt voor unieke hybride circuits met zeer fijne structuren die tegen conventionele, lage kosten geproduceerd kunnen worden. Zodoende kunnen wij de komende periode voldoen aan de groeiende vraag naar steeds kleinere en meer geïntegreerde elektronica.”

De bevindingen worden gepresenteerd op het 13<sup>de</sup> Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies congres dat van 19 t/m 21 april in Nara, Japan zal plaatsvinden.

**EINDE**

#### **OVER NEWAYS**

Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS (Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische componenten als complete (box-built) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per ultimo 2016 in totaal 2.612 medewerkers. In 2016 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 393 miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). [www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com)



**VOOR MEER INFORMATIE**

Huib van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) / Adrie van Bragt (COO)  
Tel: + 31 (0)40 – 267 9205

Neways Electronics International N.V.  
Postbus 69, 5690 AB SON  
[www.newayselectronics.com](http://www.newayselectronics.com)